



即时发布

EV集团推出面向大批量生产的下一代 EVG®120 全自动涂胶机

全新超紧凑平台集成原位光刻胶厚度测量与晶圆边缘曝光功能，兼具 EVG®150 级别性能，在更小占地空间内实现高度灵活性。

奥地利圣弗洛里安，2026年2月25日 —— 领先的创新型工艺解决方案与技术供应商 EV 集团 (EVG) 今日发布下一代 EVG®120 全自动涂胶机，这是对其旗下主流涂布/显影平台的一次重大升级。新一代 EVG®120 采用全新紧凑架构，融合多项突破性功能与源自广泛应用 EVG®150 系统的设计优化，在吞吐量、灵活性与工艺控制方面相比前代产品显著提升。此外，EVG®120 系统尺寸更小，尤其适合产品种类多样、光刻胶涂布工艺复杂，且对生产灵活性要求极高的客户。

新一代 EVG®120 系统是先进封装、微机电系统 (MEMS)、图像传感器、光子学、功率器件、晶圆探针卡及其他快速增长应用领域的理想选择。它支持旋涂、喷涂及显影等多种光刻胶工艺，兼容从 2 英寸至 200 毫米的多种衬底类型与尺寸，并可处理包括薄型、厚型、正性与负性光刻胶、介电材料 (如 PI 和 PBO) 以及用于特殊应用的黑色/彩色/红外光刻胶在内的多种材料。



EV 集团的新一代 EVG®120 全自动涂胶机采用超紧凑平台设计，与前代产品相比，大幅提升了吞吐量、灵活性与工艺控制能力。

来源：EV集团

新平台，功能扩展

EVG®120 围绕一个紧凑的 200 毫米平台进行了重新设计，集成多达两个湿法处理模块与 14 个烘烤/冷却板。相比上一代平台，产能提升达 40%。该系统占地面积也减少 20% 以上，同时设计优化也使设备维护更为便捷，模块化配置更加灵活。

该系统还引入了前几代系统所不具备的多项新功能，包括：

- **晶圆边缘曝光 (WEE)** – 可实现选择性边缘曝光，从而提高边缘精度和均匀性
- **原位光刻胶厚度测量**——可实现实时过程监控，从而提高良率和工艺控制（测量范围：50 纳米至 50 微米）
- **增强型高粘度点胶系统**——采用闭环反馈的高压点胶技术，可在厚光刻胶上实现精确涂覆性能
- **支持SMIF装载口**——实现更清洁、更高效的物料搬运
- **待机模式**——降低闲置期间的能耗；符合 SEMI E167 标准

这些新增功能建立在 EVG 成熟的涂层技术基础之上，如其创新的 CoverSpin™ 碗状设计，可提供卓越的涂布均匀性并减少材料消耗；以及其专有的 OmniSpray® 保形喷涂技术，可为复杂表面结构和易碎基板的表面实现最佳涂层覆盖。

EV 集团企业技术总监 Thomas Glinsner 博士表示：“下一代 EVG®120 平台利用 EV 集团在光刻胶与光刻工艺领域数十年的经验积累，能够满足客户从研发到量产的快速多样化需求。凭借原位测量、晶圆边缘曝光等新增功能，以及从 EVG®150 平台继承的特性，EVG®120 在一个紧凑、可投入生产的平台上，实现了无与伦比的涂胶与显影性能、产能、灵活性以及拥有成本优势”

产品上市信息

EVG 已开始接受下一代 EVG®120 系统的订单，并在公司总部提供设备演示。更多信息，请访问：<https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg120>。

关于EV集团 (EV Group)

EV集团 (EVG) 提供创新型工艺解决方案与专业技术, 服务于前沿及未来的半导体设计与芯片集成方案。公司致力于新技术的前瞻开发, 支持下一代微纳制造技术的应用, 协助客户成功实现新产品创意的商业化。EVG 的大批量生产就绪产品, 包括晶圆键合、光刻、薄晶圆处理与量测设备, 持续推动半导体前端微缩、3D 集成、先进封装以及其他电子与光子学应用的发展。更多信息, 请访问: www.EVGroup.com

联系人:

Clemens Schütte

市场与传播总监

EV 集团

电话: +43 7712 5311 0

E-mail: Marketing@EVGroup.com

Wanli Ding

客户经理

北京纵横传讯公关顾问有限公司

电话: +86 10 8580 4258

E-mail: wanli.ding@sprg.com.cn

###